技術コラム

アルミニウムの腐食のおはなし その6

The Fundamentals of Corrosion of Aluminum VI

兒 島 洋 一	本川 幸翁	大谷良行	
Yoichi Kojima	Yukio Honkawa	Yoshiyuki Oya	

1. はじめに

5年ほど前、「アルミニウム合金と鉄鋼材料とで一番 違うところは何か。」との甚だ漠たる質問を、博士課程で の鉄鋼材料の研究を経験してから入社してきた材料屋研 究員にしてみたところ、「アルミニウムはマルテンサイ ト変態しない。」との即答を得、目から小鱗の感があった。 自問自答してみるに、「アルミニウムには活性態が見え ない。」というのが腐食屋としてのその頃の思いであっ た。活性態が見えないことで、不動態化/脱不動態化、 局部腐食の発生・成長がイメージしにくかったからであ る。最近では、「鉄は酸に易溶し、アルカリで不動態化 するが、アルミニウムはどちらにも溶ける両性金属で、 アルカリ側でより溶けやすい。」という答がより相応しい と実感している。このような特徴に起因するアルミニウ ム(AI)の腐食挙動について、諸先達の研究に基づきなが ら"おはなし その6"として続けさせていただく。

2. 両性金属

2.1 アルミン酸イオン

室温の5%NaOH水溶液に浸漬した99.5%Alの腐食速 度を図1¹⁾に示す。このように、アルカリ性水溶液に金 属Al片を浸漬するとAl片の表面がほぼ均一に溶解し、 同時に水素ガス(H₂)が発生する。このときの腐食反応 は次の式(1)で示される。

腐食反応 $Al+H_2O+OH^- \rightarrow AlO_2^-+3/2H_2$ (1) これは次式のアノード反応とカソード反応とに分解して 示される。

アノード反応
$$Al+4OH^{-} \rightarrow AlO_2^{-} + 2H_2O + 3e$$
 (2)

カソード反応 $3H_2O+3e \rightarrow 3OH^++3/2H_2$ (3) アルミニウムイオン (Al^{3+}) は水酸化物イオン (OH^-) と容易に錯イオンをつくり²⁰, さらに Al/AlO_2^- の平衡電位が H_2O/H_2 のそれより十分に卑なため,こうした腐食反応 が進行する。





25℃における, bayerite (β -A₂O₃·3H₂O)の溶解度に与 える pHの影響³), および Al-bayerite-H₂O系の電極電位 -pH平衡図 (*E*-pH図)を図2 (a) ³) および(b) にそれぞれ 示す。Al は酸性側では Al³⁺ として, アルカリ性側ではア ルミン酸イオン (AlO₂⁻) として水 (H₂O) 環境中に溶出す る両性金属であることが分かる。両性金属には, Al の他 に亜鉛 (Zn), 錫 (Sn), 鉛 (Pb) などがある。図2 (a) より, Al の水酸化物および水和酸化物の溶解度が最も小さく なる pH は約5 と酸性側に寄っている。Zn および Pb のぞ れは9 より大きい³)。こうして Al の不動態 pH 域はより 酸性側に広く, アルカリ側で狭い。酸性雨に対しては Al の方が Zn めっき鋼板より耐食的であるが, コンクリー トなどの弱アルカリ性環境では,不動態化できる鉄 (Fe) は安心できるのに対して, Al の腐食速度は無視できない 場合がある^{4),5}。

2.2 水和酸化物

図2 (a) および(b) をこうして縦にならべて描くと(b) のE-pH図中で平衡pHを示す縦線の意味を理解しやす い。Pourbaixの書³⁾には、金属Alの表面に生成しうる皮 膜、腐食生成物としてbayeriteの他にamorphous hydroxide (Al (OH)₃), corundum (α -A₂O₃), boehmite $(A_2O_3 \cdot H_2O)$, hydrargillite $(\alpha - A_2O_3 \cdot 3H_2O)$ などが挙げ られており,これらのうちhydrargillite が熱力学的に最も 安定であるということから,Al-H₂O系の*E*-pH図として Al-hydrargillite-H₂O系のそれが載っている。Pourbaix に倣ってAl-hydrargillite-H₂O系の*E*-pH図が他書でも 多く見られると思われるが,70~85℃以下の水中の腐食 生成物はhydrargilliteでなくbayeriteであるとGodard の書⁶⁾にあることから,図2(b)にはAl-bayerite-H₂O系 の*E*-pH図を詳細に描いてみた。図2(a)には hydrargilliteの溶解度も合わせて示している。bayerite の溶解度の方が少し大きく,これを反映して*E*-pH図の 不動態pH域はbayeriteの方が少し狭くなる。



図2 25℃における,バイヤライト(Al₂O₃・3H₂O)-Al³⁺-AlO₂⁻⁻ 系の溶解度に与えるpHの影響(a)³⁾,およびAl-バイヤ ライト-H₂O系における電極電位-pH平衡図(b)

Fig.2 pH influence on solubility for bayerite $(Al_2O_3 \cdot 3H_2O) - Al^{3+}-AlO_2^-$ system (a) ³⁾, and electrode potential – pH equilibrium diagram for Al-bayerite-H₂O system (b), at 25°C.

2.3 脱不動態化pH

99.5%A1のNaOH水溶液中303Kおよび333Kにおける 腐食速度⁷,および6061合金の1M Na₂SO₄を基本とした 水溶液中299Kにおける自然電位のpH依存性⁸⁾を図3 (a)および(b)にそれぞれ示す。ただし、本報を含め、腐 食のおはなしシリーズで引用した電極電位値は、全て標 準水素電極 (standard hydrogen electrode: SHE) 基準へ の換算値を示した。これらの腐食速度、自然電位のpH 依存性に関しては"おはなし その3" 9 でH2O環境のカ ソード反応の同依存性とともに詳述した。すなわち, pH の上昇とともに式(2)のアノード反応が速くなり、これ を賄うカソード反応として式 (3)の反応が必要になった pHで自然電位が急激に卑化する、というものである。 孔食を誘起しうる塩化物イオン (Cl-) 環境であれば、こ の急激に卑化するpHより酸性側で孔食が起こり、アル カリ性側で均一腐食が進行し孔食は起こらない。こうし た腐食形態に関する臨界pHは、鉄鋼材料に関する酸性 側の脱不動態化pH (pH_d)の概念⁴⁾に類似する。片やAl に関する酸性側ではpHによる腐食形態の変化は不明瞭 である。海水程度のCl-濃度環境であれば、塩化アルミ ニウム (AlCl₃)の飽和水溶液のpHである2.3以下であっ ても,水素イオン(H⁺)のH₂への還元をカソード反応と して、 孔食などの局部腐食と均一腐食とが同時に進行し うる。

アルカリ側の臨界pHを本報ではpHdbaseと記す。図3 (a) では腐食速度の立ち上がるpHは303Kよりも333K でより低い。より高温の368~393KではpH 7~8で立 ち上がる¹⁰⁾。こうしてpH_d^{base}は温度の影響を大きく受 けて低くなる¹¹⁾。熱力学的平衡を示すE-pH図を基に, 電極電位(E)とpHとに関する腐食領域図を考察する場 合,Alに限らず溶存イオン濃度10-6 Mを基準とするこ とが慣例である^{4),12),13)}。図3(b)にもみられるように、 実験的に観察される pH_d^{base} は E-pH 図において AlO₂- 濃 度を10⁻⁴ Mとしたときの平衡 pH¹⁴と対応している。腐 食形態領域を考察する場合には、10⁻⁶ Mでない平衡 pH が有用な場合もある。以前15)にも述べたが、各腐食形態 (corrosion form)¹⁶⁾の名称は、必ずしも侵食形状 (penetration shape)と対応した意味合いの用語でなく、 腐食機構に基づく分類名称である。各腐食事例における 腐食形態の把握は、防食設計に根本的方向性を与えるも のとして重要である。



- 図3 99.5%AIのNaOH水溶液中303Kおよび333Kにおける 腐食速度(a)⁷,および6061合金の1M Na₂SO₄水溶液中 299Kにおける自然電位(b)のpH依存性⁸⁾
- Fig.3 Corrosion rate of 99.5% AI in NaOH solution at 303K and 333K (a) 7 , and open circuit potential of 6061 alloy in a deaerated 1M Na_2SO_4 solution at 299K (b) 8 as a function of pH.

3. カソード腐食

3.1 カソード近傍のpH上昇

腐食反応において,アノード近傍ではAl³⁺が式(4)の ように加水分解し,pHが下がる。

(4)

 $Al^{3+} + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + 3H^+$

これに対してカソード近傍のpHは上がる。H2O環境のカ ソード反応⁹⁾がすべて、H⁺消費またはOH⁻生成であるか らである。これらのpH変化は、アノードとカソードとが 場所的に重なっている場合は互いに相殺されて進まない が、分離の程度が大きいほど促進される。分離したアノー ド近傍では、生成した Al³⁺および H⁺に対する電気的中性 条件の要請により、沖合溶液から陰イオンが泳動してく る。Cl-などが泳動してくるとH⁺の活量係数が増大し, pHはさらに下がる17),18)。また、分離したカソード近傍に、 沖合からアルカリ金属イオンが泳動する場合にアルカリ 化は進みやすい。アノード近傍のpH低下は, Al合金も含 まれる不動態化金属材料に起こる孔食・すきま腐食など の局部腐食の発生と成長のメカニズムに相当する。局部 腐食に限らなくても、アノード反応によるpH低下がさら にアノード反応を促進した結果、また炭素鋼の場合など はカソード反応によるpH上昇がカソード表面を不動態化 させた結果, 腐食面に凹凸ができることもある。Al合金 は、カソード近傍のpH上昇によっても腐食しうる。この 腐食形態は、両性金属であってアルカリ側の耐食pHの低いAlに特徴的であるといえ、"カソード腐食"と呼ばれる。

一般的な金属の防食法の1つに"カソード防食"があ る。これは当該材料にカソード電流を印加して、腐食が 進行している自然電位(腐食電位)より卑な電位域に保 持することでアノード反応を抑制するものである。Al 合金ではこうしたカソード電流の印加で腐食することが ある。pH11の1M Na₂SO₄+NaOH溶液中で自然電位よ り卑な電位域に保持したAlの溶解速度を図4(c)²⁾に示 す。これらの保持条件をE-pH図中にプロットしたもの を図4(a)に, 99.7%AlについてpH11の水溶液中で測定 した分極曲線を図4(b)11)にそれぞれ示す。図4(a)から 最も卑な保持電位はAl/AlO2の平衡電位あたりにあり, 図4 (b)の分極曲線から各電位では2章の式 (3)に示した H₂発生反応が活発に起こることが分かる。図4(c)では, 保持電位が卑なほど溶解速度は速い。すなわち、保持電 位が卑なほどカソード腐食が促進されており、Alの不感 域近くでの保持も例外でない。こうした現象は中性環境 でも同様である16)。これらの定電位保持時に外部電流と して測定されていたであろうカソード電流は,式(3)を 内容としたカソード電流から式 (2)を内容としたアノー ド電流を減じた値に相当している。



- 図4 電極電位-pH平衡図中の保持電位 (a), pH=11の溶液 中における 99.7% AIの分極曲線 (b)¹¹⁾, および pH=11の 1M Na₂SO₄+NaOH水溶液中で水素発生電位域に保持 した場合の溶解量
- Fig.4 Experimental potentials plotted in *E*-pH equilibrium diagram (a), polarization curves obtained for 99.7% AI in aqueous solution at pH11 (b)¹¹, and mass loss for cathodic potentiostatic polarization in 1M Na₂SO₄-NaOH solution at pH11 (c)², at 25 °C.

3.2 カソード防食

「われわれは、普通、裸の金属 Alを見ることはできな いが、もし裸の金属Alが扱えるとしてこれをカソード防 食法によって完全に防食しようとすれば、E-pH図の不 感域にあるように、その電位を下げることによって達成 される。」と久松先生の解説19)にある。この達成には、文 中にある"(不動態皮膜のない)裸の金属Alを扱える"こ との他にも仮定が必要なことは図4からも推察できる。 しかし、カソード防食により塩化物環境における孔食を 抑制することはできる。孔食は孔食電位 (*E*_{PIT})より卑に 保持することで発生を防止できるからである。さらに, EPITより卑な食孔再不動態化電位 (ER, PIT)より卑な電位 域に保持することで、たとえ孔食が進行していても、そ の進行を止めることができる。また*E*_{R,PIT}はすきま腐食 電位 (E_{CREV}) に近く, こうした電位域ではすきま腐食を も防止できる^{15), 20)}。0.03%塩化ナトリウム (NaCl) 水溶 液中の3003合金および人工海水中の5083合金にカソー ド防食を施した場合の保持電位と腐食減量との関係を 図5に示す21),22)。それぞれの合金/環境の組み合わせ で最適防食電位域があり、それより卑電位域でカソード 腐食が生じる。保持電位が最適防食電位域の下限値を下 回らないことが重要である。

Al-Mg合金では、不動態保持電流密度(*i*_{pass})およびカ ソード反応活性の環境依存性が他合金より大きい。海水 中であっても、溶存酸素(O₂)還元反応が*i*_{pass}を凌いで自 然電位を*E*_{PIT}まで押し上げて保持しにくく、これが Al-Mg合金が海洋性環境耐孔食性合金として用いられ る所以である²³⁾。これらから、5083合金の自然電位の値 域が広く、自然電位直下でのカソード防食効果が3003合 金ほど明瞭でないと推察できる。

カソード防食としては、外部電源からのカソード電流 の印加のみならず、自然電位のより卑な金属・合金を電 気的に接触させ、これを犠牲材とする方法も含まれる。 Al合金を孔食からカソード防食する犠牲材としては、Zn を添加したAl合金が用いられる。Al合金へのZn添加は E_{PIT} を卑化させ、例えば1 mass%の添加で100 mV程度 卑化する²⁴。 E_{PIT} は環境中Cl-濃度依存性が大きい¹⁵⁾が、 このようなZn添加合金を犠牲材として用いることで、 被防食合金の E_{PIT} と犠牲材の E_{PIT} とが環境のCl-濃度に 応じて連動して、その差が常に100 mV程度に保たれる。 最適防食電位域の環境依存性が問題になりにくい方法と いえる。

3.3 Znとの接触腐食

図5中には中性塩化物環境における炭素鋼およびZn の自然電位, さらにFeの平衡電位 (E_{eq} ^{Fe})も示した。Zn めっき鋼板では, Znの自然電位が E_{eq} ^{Fe}より卑なことで Feを不感域に保持する。さらに, めっきZnの腐食生成 物の平衡pHがアルカリ寄りであることも、端面などに 露出した鋼の腐食速度を遅らせる²⁵⁾。それでは、Al合金 とZnとが接触したらどうなるであろうか。Znの自然電 位とAl合金の最適防食電位域の下限値との関係は微妙 である⁴⁾が、結果としては、どちらかが犠牲材となり他 方を防食することはなく、Al合金とZnの双方の腐食が 促進されてしまう²⁶⁾。Al合金とO接触でZnの腐食が促 進され、鋼に対しては腐食抑制に働いたZnの腐食生成 物の高い平衡pHがAlには攻撃的に働く、という負の因 果関係の連鎖が起こるからである。



- 図5 0.03%NaCI水溶液中の3003合金²¹⁾および人工海水中 の5083合金²²⁾を自然電位より卑に定電位保持した場 合の腐食減量
- Fig.5 Mass loss of cathodic potentio-staticcally controlled 3003 alloy in 0.03% NaCl aqueous solution²¹⁾ and 5083 alloy in artifical marine water²²⁾.

4. カソードピット

4.1 実測腐食領域図

各種2元系合金および化合物について、ASTM G69に 従って53 g/L NaCl水溶液に3 g/L H₂O₂を添加した液 中で測定した自然電位24)を図6に示す。ほとんどの実用 Al合金は、元素を固溶した母相に第2相として化合物が 分布した複合材料として捉えることができ、こうした構 成が機械的特性のみならず溶解・腐食挙動にも様々な特 徴を与える²⁷⁾。5086合金について、海水相当のCl-濃度 の種々のpH緩衝溶液を用いて実験的に求められた腐食 領域図を図728)に示す。酸溶解,アルカリ溶解,全面で の孔食,およびカソード腐食による general attack (全面 腐食)域の中にpassivity (不動態)域が浮かんでいる。 passivity域の貴側にある pitting (孔食)域は通常の Cl- に よる孔食である。imperfect passivity (不完全不動態) 域 の下限電位は3章で述べた $E_{R,PIT}$ および E_{CREV} に相当す る。図7ではpassivity域の卑側にもpitting域が示されて いる。これは、式(3)で示したH2発生反応の過電圧が、 母相と第2相とで異なるために起こる11)。すなわち、第2 相表面では母相表面より貴な電位からH2発生が起こる



図6 高純度二元系合金および化合物の25℃の53 g/L NaCl + 3 g/L H₂O₂ 水溶液 (ASTM G69) 中自然電位²⁴⁾

Fig.6 Open-circuit potentials obtained in a solution of 53 g/ L NaCl + 3 g/L H₂O₂ at 25°C for high-purity binary alloys and intermetallic phases²⁴.



図7 5086合金について塩化物環境で実験的に求められた電 極電位とpHとに関する腐食領域図²⁸⁾

Fig.7 Experimentally determined corrosion diagram in terms of electrode potential and pH for 5086 alloy in a chloride environment²⁸⁾.

ため、こうした電位域では第2相近傍溶液がアルカリ化 して局所的なカソード腐食が起こり、ピットができる。 これをここではカソードピットという。さらに卑な general attack域では母相表面からもH₂が発生し、カ ソード腐食が全面で進行する。

4.2 生成を駆動するアノード反応

カソードピットは自然浸漬でも発生する。希薄塩化物 水溶液への自然浸漬後の3000系合金および弱アルカリ 水溶液への自然浸漬後の5000系合金に見られたピット の観察写真を図831)および図932)にそれぞれ示す。自然 浸漬状態では外部電源からのカソード電流はないので, これに相当するカソード反応および対応するアノード反 応がともに合金表面で進行する必要がある。中性環境に おける ipass レベルのアノード反応速度ではカソードピッ トは生成しない。このときの環境条件は図7中の passivity域にある。図8ではCl-孔食が、図9ではアルカ リ溶解がアノード反応速度を増加させ、これらに対応す るカソード反応が第2相表面に集中してカソードピット が生成した。図8では通常のCl-食孔(Cl- corrosion pit) とカソードピットとが隣り合うコンビネーションピット となっている。左側がカソードピットで、溶解面が滑ら かである。右側のCl-食孔部には粒界腐食も見られる。 海水環境の自然浸漬でも,通常のCF 食孔とカソードピッ トとが同時に成長する場合がある29)。このときの環境条 件は図7中のpassivity域の貴側にある。図9(a)に示し たカソードピットに関する生成メカニズムを図9(b)に 示す。このときの環境条件は図7中のpassivity域の右下 辺りのpitting域にある。本報で述べてきたことが集約 されたような現象である。通常のCl-孔食に関しては, その発生を促し、成長を駆動するのがカソード反応であ るという考え方をするが、カソードピットに関しては、 それが入れ替わった主客逆転が面白い。



- 図8 希薄塩化物水溶液に自然浸漬した3000系合金に生成したCFおよびカソードコンビネーションピットに関する,断面の光学顕微鏡写真(a),およびピット底部のSEM写真(b)³¹⁾
- Fig.8 Cross section photograph (a), and SEM image of the bottom surface (b) for the Cl⁻ and cathodic combination corrosion pit generated on 3000 series alloy under dilute chloride environment³¹.



- 図9 弱アルカリ性水溶液に自然浸漬した5000系合金に生成したカソードピットに関する, SEM写真 (a), および生成機構の模式図 (b)³²⁾
- Fig.9 SEM image (a), and schematic illustration of generation mechanism (b), for the cathodic corrosion pit generated on the 5000 series alloy under mildly alkaline environment³².

5. おわりに

昨年,表面技術協会殿主催のセミナー30)で午前中の講 義を1コマ仰せつかった際、腐食挙動についてひととお り話し終えてから、「アルミニウムは、四面楚歌で逃げ 道の塞がれた"絶望的な金属"である。」と申し上げた。こ この四面とは、もちろん電位-pH図における貴・卑・酸・ アルカリのことである。アルミニウム合金メーカーに身 を置きながら "絶望的な金属"とは不謹慎極まる発言と お叱りを受けるかもしれないが、セミナーがアルミニウ ムの表面処理技術者を対象としていたため、「だからこ そ、表面処理技術が重要。」と続けるために用いた表現で あった。意図に反して、"表面処理技術の重要性"よりも "腐食挙動の絶望性"を強く印象付けてしまったためか、 続きのコマの講師の先生方の幾人かが,「アルミニウム は"絶望的な金属"でありますが、…」と小職の言をその 日のKeywordのように引用され,終日苦笑することと なった。アルミニウム合金が、適切な合金選択・防食設計・ 表面処理のもと、その自力が過小、過大に評価されるこ となく、使用される製品群が今後も増え続けることを願 いながら,本年も大方のご批判を切に請う次第である。

参考文献

- 1) E. Nactigall : Aluminium, 33 (1957), 95.
- 2) H. Kaesche : Metallic Corrosion, NACE, (1985), 270.
- M. Pourbaix : Atlas of Electrochemical Equilibrium in Aqueous Solutions, Pergamon Press, (1966), 168.
- 腐食防食協会編:材料環境学入門,丸善,(1993),19,24,97, 98,261,269.
- 5) 高谷泰之, 山川宏二, 吉沢四郎: 材料, 35 (1986), 25.
- H. P. Godard, W. B. Jepson, M. R. Bothwell and R. L. Kane : The Corrosion of Light Metals, John Wiley & Sons, Inc., (1967), 4, 9.
- M. R. Tabrizi, S. B. Lyson, G. E. Thompson and J. M. Ferguson : Corrosion Science, **32** (1991), 733.
- T. C. Tan and D. T. Chin : J. Electrochem. Soc., 132 (1985), 766. P. Drodten : Corrosion Resistance of Aluminium and Aluminium Alloys, Wiley-VCH, (2010), 468, 490, 475.
- 9) 兒島洋一: Furukawa-Sky Review, 4 (2008), 73.
- 10) H. H. Uhlig and R. W. Revie : Corrosion and Corrosion Control 3rd ed., John Wiley & Sons, (1985), 341. 岡本剛他監訳 腐食反応とその制御第3版, 産業図書, (1989), 353.
- 本川幸翁,坂井一成,兒島洋一:材料と環境2010講演集,腐 食防食協会,(2010),363.
- 12) G. Wranglén: An Introduction to Corrosion and Protection of Metals, 吉沢四郎他訳 金属の腐食防食序論, 化学同人, (1973), 231.
- 13) 腐食防食協会編:金属の腐食・防食Q&A, 丸善, (1988), 154.
- 14) 池田洋: 住友軽金属技報, 41 (2000), 134.
- 15) 兒島洋一: Furukawa-Sky Review, 2 (2006), 62.
- M. G. Fontana and N. D. Greene : Corrosion Engineering, McGraw-Hill, (1967), 28.
- 17) 増子 曻, 高橋正雄: 電気化学―問題とその解き方―, アグ ネ技術センター, (1993), 98.
- 18) 高橋正雄:防食技術, 23 (1974), 625.
- 19) 久松敬弘: 軽金属, 18 (1968), 173.
- 20) 当摩 建, 竹内 庸: 軽金属, 29 (1979), 498.
- 21) 田部善一, 萩原理樹, 重光治: 防食技術, 23 (1974), 485.
- 22) 軽金属協会:アルミニウム材料の基礎と工業技術,軽金属協 会,(1985),215.
- 23) 大谷良行, 兒島洋一: 材料と環境 2008 講演集, 腐食防食協会, (2008), 371.
- 24) J. R. Davis : Corrosion of Aluminum and Aluminum Alloys, ASM, (1999), 28.
- 25)日本鉄鋼協会 材料の組織と特性部会:建材用塗装鋼板の端 面防錆機構解明および寿命予測研究会報告書,日本鉄鋼協会, (2009).
- 26) 宮島知久,小林敏明,倉田正裕, 兒島洋一:材料と環境2011 講演集, 腐食防食協会, (2011), B204.
- 27) 軽金属学会 研究委員会 表面技術部会:研究部会報告書 No.22, アルミニウム合金の表面処理性に及ぼす金属間化合物 の影響(その1)調査報告,軽金属学会,(1990), 2.
- 28) Ph. Gimenez, J. J. Rameau and M. C. Reboul : Corrosion, 37 (1981), 673.
- 29) Kemal Nisancioglu : Corrosion behavior and protection of copper and aluminium alloys in sea water, edited by D. Féron, Woodhead Publishing, (2007), 145.
- 30) 表面技術協会:第30回ライトメタル表面技術部会サマーセミ ナー,表面技術協会,(2010),7.
- 31) 大谷良行:未発表
- 32) 本川幸翁:未発表



兒島 洋一 (Yoichi Kojima) 技術研究所



本川 幸翁 (Yukio Honkawa) 技術研究所



大谷 良行 (Yoshiyuki Oya) 技術研究所